证券代码：301312

证券简称：智立方

深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会（2024年度业绩说明会） ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025年4月25日 15:00-15:30
地点	全时平台（电话会议和网络文字互动形式召开）
上市公司接待人员姓名	董事长：邱鹏 董事会秘书兼财务负责人：廖新江 证券事务代表兼法务负责人：苏晓倩 保荐代表人：民生证券股份有限公司 秦亚中 独立董事：肖幼美、张淑钿、杜建铭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会通过电话会议和网络文字互动形式对公司2024年度经营、战略、财务情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。</p> <p>一、2024年度经营、战略情况介绍</p> <p>1. 主营业务介绍：</p> <p>公司属于高端装备制造行业，是一家专注于半导体及工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的国家级高新技术企业，为下游客户半导体工艺制程、智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。</p>

公司的核心业务聚焦于两大赛道：半导体与电子产品赛道。公司积极响应国家半导体产业国产化的战略号召，已成功进入半导体赛道，将产品线延伸至显示半导体、光通信半导体、MEMS 传感器及 CIS 传感器半导体、功率器件等关键领域。公司依托自主研发的核心技术，成功推出了 Mini LED/Micro LED 芯片分选机、AOI 检测设备、光通讯芯片精密排巴机、固晶机等一系列智能制造装备，通过不断技术革新、产品迭代及工艺优化，提升了中国显示半导体行业在对应工艺环节的综合竞争力，加速了中国显示半导体的产业化进程。在显示半导体及光通信设备等领域，公司已顺利导入多家头部客户，已获得较高的市场份额。

公司深耕行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务，与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包括苹果公司、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团、长光华芯、乾照光电、兆驰股份、华灿光电等全球知名电子产品智能制造商及国内知名光电子器件企业。

2. 经营战略分析：

电子产品赛道是公司的传统优势赛道，历经多年深耕细作，公司的自动化测试设备及自动化组装设备产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业，精准满足客户在光学、电学、力学等多维度的高标准测试需求及高效组装需求。

公司基于在半导体设备领域的精密光学、精密机械、运动控制、软件开发、算法开发等技术基础及整体方案解决能力优势，主动适配全球芯片制造商的严苛标准，通过前瞻性研发创新与智能化制造体系，确保设备输出精度、稳定性及能效比，持续满足客户对超高良率与降本增效的核心诉求。目前，公司深度嵌入多家头部半导体厂商的供应链体系，凭借快速定制化响应与关键工艺参数优化，实现从单一设备供应到联合工艺开发的战略合作升级，构筑起长期互信的业务生态。

3. 财务情况回顾：

2024 年度，公司实现营业收入 55,460.53 万元，同比增长 29.77%；归属于上市公司股东的净利润 5,949.24 万元，同比下降 18.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,444.94 万元，同比下降 32.32%。

公司作为国家级高新技术企业，报告期内，公司坚持以自主创新为核心，研发具有自主知识产权的核心技术，建立了灵活、高效的研发体系，并密切跟踪行业发展趋势，把握市场需求提前布局技术研发以快速满足客户产品的技术要求。公司

重视研发投入，2022年至2024年研发费用分别为4,826.71万元、5,425.99万元和5,362.71万元，占当期营业收入比例分别为9.50%、12.70%和9.67%。

二、主要问答环节

1. 公司2024年营业收入同比增长29.77%，但归母净利润同比下降18.02%，主要原因是？

回复：2024年净利润下降主要受以下因素影响：（1）产品结构变化，半导体设备验收周期长。（2）研发投入持续加大，全年研发费用5,362.71万元，占营业收入比例为9.67%，重点投向半导体设备及技术研发。

2. 半导体业务进展如何？是否成为核心增长引擎？

回复：半导体业务是公司第二增长曲线，2024年取得显著突破：（1）产品矩阵完善：分选机、AOI设备等已批量交付，CIS芯片分选设备获头部客户量产订单，先进封装设备进入验证阶段；（2）客户拓展：覆盖显示半导体（华灿光电、兆驰股份）、光通讯（长光华芯、中际旭创）、传感器（格科微）等领域，新增硅光领域客户；（3）收入贡献提升：半导体设备收入占比显著提升，预计2025年随新品放量进一步增长。

3. 请问公司如何看待关税政策变化对公司的影响？

回复：本次加征关税对公司没有直接影响。公司与客户保持了紧密沟通，公司出口业务主要采用FOB交易方式，关税和运费由客户承担，公司已经凭借竞争力和客户形成了生态链深入绑定。公司也将密切关注国际贸易环境的变化、行业趋势及产生的潜在影响，减少关税带来的影响。

4. 请简述2025年消费电子自动化设备行业景气度及展望业务成长性。

回复：消费电子行业终端需求在AI人工智能等新技术的推动下有所复苏，AI人工智能技术和新兴智能硬件产品的融合，为消费电子行业带来了新的发展契机。在新产品、新业务方面，公司充分肯定人机交互、虚拟现实等产业未来在娱乐、健康、家居安防等不同领域的发展空间。

5. 请简述公司研发投入方向及核心技术成果。

回复：公司产品研发聚焦半导体领域两大产品线：高精度固晶及先进封装解决方案及设备、芯片检测分选解决方案及设备；技术研发聚焦三大核心能力：高精度机械设计及制造技术、精密运动控制技术、高精度视觉成像及定位缺陷检测技术。

6. 请简述公司如何通过战略布局实现半导体设备业务的持续突破？

回复：公司以“横向技术延伸+纵向行业深耕”双轮驱动战略为核心，构建“产业+行业”的发展地图：（1）横向拓展产品矩阵，从核心设备向半导体前中后道全流程延伸，覆盖分选、检测、封装等关键环节，持续丰富高附加值产品线；（2）纵向深化行业场景：聚焦Mini/Micro LED、光通讯、传感芯片与IC封测等细分领域，联合战略客户定制开发工艺解决方案，强化行业渗透力；（3）创新业务模式，公司积极布局芯片分选测试代工业务，依托自主研发与自产设备的技术优势，以及芯片厂战略大客户的资源支持，强化产业链协同效应。

7. 请简述公司在半导体赛道的全球化区位布局上有哪些具体规划？

回复：公司围绕“技术-生产-市场”闭环，打造差异化区位系统网络。（1）深圳：定位半导体研发中枢，聚焦核心技术攻关与产品迭代，推动底层技术突破；（2）东莞：依托大湾区Mini/Micro LED产业集群，建设专业化生产基地，实现快速交付与规模化产能支撑；（3）苏州：深耕长三角半导体产业链，强化客户需求响应与区域市场覆盖，打造营销联动的战略支点；（4）越南：辐射东南亚，通过本地化服务团队切入新兴市场，完善国际化业务版图。

8. 请公司简述与瑞士施耐德博格的合资公司进展及未来规划。

回复：2024年是深圳施耐德博格完整运营的首个会计年度，公司成功实现了从技术整合到商业化落地的跨越式发展，体

现了技术转化与市场拓展的高效协同，为后续规模化发展奠定基础。合资公司与国内半导体产业链核心企业达成深度合作，重点覆盖前道晶圆量测、先进封装等环节，部分设备已通过头部客户的量产验证并实现稳定交付。

9. 请公司简述汽车电子产品情况。

回复：公司在汽车电子领域提供抬头显示的整机组装、车载扬声器及激光投影光机的组装和测试等产品。

10. 请公司简述雾化电子领域的战略规划。

回复：公司在雾化电子领域专注于电子烟弹的全自动组装及生产，雾化电子相关的营业收入规模在公司整体营业收入规模中的占比较低，公司未来将继续积极拓展雾化电子相关的业务。

11. 请公司简述募投项目延期的原因。

回复：“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”由预定可使用状态日期（2025年7月）延期至2027年7月，主要系实际投入过程中，受到外部宏观环境、行业内部环境变化及整体工程进度不及预期等因素的影响，募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度进行调整。

12. 请简述公司一季度业绩大幅增长的原因。

回复：公司一季度实现营业收入1.61亿元（去年同期0.81亿元），主要系销售规模显著扩大，半导体客户订单交付量同比大幅提升。

13. 在目前形势下，请简述客户订单情况，展望全年会是什么趋势？

回复：公司客户的生产规划和订单在按计划快速推进，整体看全年业绩拟保持乐观发展趋势。

	<p style="text-align: center;">14. 请公司简述 2024 年分红计划及未来分红政策。</p> <p>回复：公司 2024 年拟以现有总股本 87,195,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4 元（含税），分红总额 3,487.82 万元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 58.63%；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司坚持“持续回报股东”原则，在兼顾公司发展和业务开拓的基础上，公司希望加大分红力度与频次，与投资者持续共享收益，敬请关注后续信息披露情况。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 25 日